



Technical Data Sheet

FeedBond® TP-60-3

非矽型導熱膏

A. 產品描述

FeedBond® TP-60-3 是一款不含有機矽氧烷成份的高導熱材料，導熱係數可達 15 W/mK，不會有矽氧烷樹脂揮發也無矽油析出，利用非矽型導熱膏的傳導高瓦數晶片熱量特性，從而能提高電子元件的使用壽命和效率。

B. 產品特性

- 無添加溶劑
- 高導熱係數
- 無添加有機矽材料

C. 產品應用

- 高功率電競晶片、中央處理器 CPU、繪圖處理器 GPU
- LED 照明設備
- 智慧型手機和平板
- 投影機設備

D. 規格

產品特性	值	單位	測試條件
外觀	黑色	-	目視
黏度 @25°C	75,000	cps	Brookfield DV-III/CP-52 @5 rpm
比重 @25°C	2.5	-	比重計
重量損失	<0.5	wt%	48hrs @100°C
熱傳導係數	15	W/mK	Hot Disk(Sensor 5501、Slab)
電阻	>10 ⁶	Ω	電阻計
工作溫度	-40 ~ +120	°C	-
包裝	針筒(Syringe)、罐裝(Pot)		
貯存條件	室溫下可保存 12 個月		

此表僅提供一般之測試數據，若您需要詳細的產品規格，請與我們連絡。



E. 熱傳導係數分析儀(Hot Disk Thermal Constants Analyzer) :



F. 電競桌上型電腦超頻溫度比較測試 :

測試環境溫度: 25°C、濕度:70%RH

■ 他牌產品測試結果:

J601B: > 1.2W/mK

Intel Core i9 11900K			
+ Voltages			
- Temperatures			
	Value	Min	Max
Package	74.0 °C	69.0 °C	81.0 °C
Cores (Max)	72.0 °C	68.0 °C	80.0 °C

■ 肥特補科技 TP-60-3 測試結果:

TP-60-3: 15 W/mK

Intel Core i9 11900K			
+ Voltages			
- Temperatures			
	Value	Min	Max
Package	70.0 °C	67.0 °C	75.0 °C
Cores (Max)	71.0 °C	68.0 °C	75.0 °C

G. 一般資訊

- 有關本產品的安全處理信息，請諮詢安全數據表 (SDS)。
- TDS 文件數據資料是在肥特補科技股份有限公司內實驗室條件下進行測試。